

第 13 届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀学者论坛二轮通知

为了促进学科发展，充分发挥中国硅酸盐学会的学术交流优势和《硅酸盐学报》、*Journal of Materiomics*、*InfoMat*（均为“中国科技期刊卓越行动计划”入选期刊）、*InfoScience*作为开展学术交流、学术争鸣重要园地的作用，第13届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀学者论坛将于2023年8月25日~8月27日在四川省成都市举办。该研讨会和论坛由中国硅酸盐学会主办，电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室承办。

一、研讨主题

先进土木工程材料、先进功能陶瓷材料、先进结构材料、超导材料与器件、光电信息材料与器件、新型二维材料与器件、先进能源材料、先进催化材料、先进表征与装置。

二、会议时间及地点

1、报到时间及地点：

8月25日全天，成都新希望高新皇冠假日酒店。

2、会议日期及地点：

8月26日8:30~18:00，8月27日8:30~17:00，成都新希望高新皇冠假日酒店。

3. 会议住宿：

成都新希望高新皇冠假日酒店、成都新希望高新中心假日酒店（四川成都郫都区西芯大道1号）。

三、会议组织

大会主席：高瑞平（中国硅酸盐学会理事长）

南策文（中国硅酸盐学会副理事长，中国科学院院士，
清华大学教授）

李言荣（西北工业大学党委书记，中国工程院院士）

执行主席：晋占平（中国硅酸盐学会副理事长）

熊 杰（电子科技大学物理学院院长）

四、分会场设置

第 1 分会场：先进土木工程材料。主席：缪昌文院士、史才军、
张文生、冉千平、钱春香。

第 2 分会场：先进功能陶瓷材料。主席：邓龙江院士、张金星、
王轲、肖旭、毕磊。

第 3 分会场：先进结构材料。主席：董绍明院士、张幸红、邹冀、
范宇驰、董顺。

第 4 分会场：超导材料与器件。主席：陈仙辉院士、程金光、乔
梁、郭建刚。

第 5 分会场：光电信息材料与器件。主席：刘益春院士、李亮、
王中强、王显福、田维。

第 6 分会场：新型二维材料与器件。主席：张跃院士、狄增峰、
张铮、徐川、田子傲。

第 7 分会场：先进能源材料。主席：成会明院士、余彦、禹习谦、

牛志强、康卓。

第 8 分会场：先进催化材料。主席：俞书宏院士、邹如强、李彦光、周伟家。

第 9 分会场：先进表征与装置。主席：王中林院士、谷林。

第 10 分会场：无机非金属材料学科优秀学者论坛。召集人：张幸红、李亮。

五、会议注册

1、网络注册 请登录以下网址 <https://inmc13.ceramsoc.com/>或扫描二维码进行会议注册、提交摘要和缴费。



请扫描中国硅酸盐学会会员之家
小程序报名参会

2、注册费

2023年7月31日前(含7月31日)支付，2200元/人(在校学生1200元/人)；

2023年8月1日后或现场支付，2500元/人(在校学生1500元/人)。

如需对公转账，收款信息为：

户名：中国硅酸盐学会

开户银行：中国工商银行北京百万庄支行

账号：0200001409014435189

汇款时请注意：备注好第13届研讨会注册费和参会者姓名；如为学生请额外注明。

六、论文征集

1. 征文范围

征文范围包括但不限于以下内容：先进土木工程材料、先进功能陶瓷材料、先进结构材料、超导材料与器件、光电信息材料与器件、新型二维材料与器件、先进能源材料、先进催化材料、先进表征与装置。

2. 投稿

请登录 <https://inmc13.ceramsoc.com/> 在线提交论文摘要。论文摘要收稿截止日期：2023年8月1日。

参加研讨会交流并提交全文的论文(中、英文均可)经评审合格后，择优在 *Journal of Materiomics* (<http://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-materiomics>) 和《硅酸盐学报》 (<http://www.jccsoc.com>) 上刊发。全文投稿请登录期刊网站，收稿截止日期：2023年9月1日。

七、会议食宿

1、酒店预订

请扫描以下二维码预订酒店。会议房间有限,请于2023年7月31日前(含7月31日)预订。预订咨询:郭兰英 13678037442(fran.guo@cpdwest.com)。



成都新希望高新皇冠假日酒店



成都新希望高新中心假日酒店

2、会议期间食宿费用自理。

八、会议联系

中国硅酸盐学会:

周立忠(13522585433, zhoulizhong2010@163.com)

张津溥(13671252214, zhangjinpu@gsyxb.wecom.work)

电子科技大学:

晏超贻(18780138749, inorgmat@uestc.edu.cn)

九、展览展示联系

中国硅酸盐学会:

张津溥(13671252214, zhangjinpu@gsyxb.wecom.work)

电子科技大学:

晏超贻(18780138749, inorgmat@uestc.edu.cn)

中国硅酸盐学会

2023年6月8日